

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HannStar Board International Holdings Limited

瀚宇博德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：667)

關連交易

收購瀚宇精密科技(江陰)有限公司 之全部股本權益

董事會欣然宣佈，本公司之直接全資附屬公司瀚宇香港與瀚宇精密薩摩亞訂立該協議，以在該協議所載之條款及條件之規限下，按總代價1,900,000美元(相當於約人民幣14,000,000元)收購其於瀚宇精密之全部股本權益。於收購事項完成後，瀚宇精密將成為本公司之間接全資附屬公司。

由於瀚宇精密薩摩亞為瀚宇台灣之間接全資附屬公司，而瀚宇台灣為本公司之控股股東，根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司之關連交易。由於相關百分比比率(誠如上市規則所載)按照年度基準計算少於2.5%，根據上市規則第14A.32條，收購事項獲豁免遵守獨立股東批准規定，而僅須遵守報告及宣佈規定。

該協議

訂立日期

二零零七年十二月二十四日

涉及各方

賣方：瀚宇精密薩摩亞(瀚宇台灣之間接全資附屬公司)

買方：瀚宇香港(本公司之直接全資附屬公司)

所收購之權益

根據該協議，瀚宇精密薩摩亞同意出售而瀚宇香港同意收購瀚宇精密(為瀚宇台灣之間接全資附屬公司)之全部股本權益。

代價及付款期

代價為1,900,000美元(相當於約14,780,000港元)，本公司將於該協議簽署日期起計10個工作天內以現金支付。

根據中國公認會計原則編製之瀚宇精密於二零零七年十一月三十日之經審核資產淨值約為人民幣14,000,000元(相當於約14,780,000港元)。代價乃參照根據中國公認會計原則編製之瀚宇精密於二零零七年十一月三十日之經審核資產淨值按公平原則磋商後釐定。基於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為代價乃按公平合理基準釐定。

進行收購事項之理由及益處

目前，本公司主要從事大量生產及於全球銷售主要用於筆記本電腦之雙面印刷電路板及多達12層之多層印刷電路板。本公司亦提供電子消費品用於遊戲機、機頂盒、伺服器及移動電話之印刷電路板。鑑於消費者對輕巧手提式消費電子產品之需求越來越高，兼具剛柔特性之剛柔電路板之相應需求亦越來越高，董事認為生產剛柔電路板未來具有良好之商業潛力，可讓本集團將其產品組合作多元化發展，而鑑於剛柔電路板市場近來之升勢，日後能為本集團提供額外收入來源。董事相信收購事項能為本集團提供機會利用瀚宇精密製造柔性印刷電路板方面之專業知識，並將之結合其生產印刷電路板方面之專業知識，從而讓本集團就生產剛柔電路板進行進一步研發，進軍剛柔電路板市場。

董事(包括獨立非執行董事)認為該協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合股東及本公司之整體利益。

上市規則之影響

由於瀚宇精密薩摩亞為瀚宇台灣之間接全資附屬公司，而瀚宇台灣為本公司之控股股東，根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司之關連交易。由於相關百分比比率(誠如上市規則所載)按照年度基準計算少於2.5%，根據上市規則第14A.32條，收購事項獲豁免遵守獨立股東批准規定，而僅須遵守報告及宣佈規定。本公司將就關連交易遵守上市規則之相關條文。

有關瀚宇精密之資料

目前，瀚宇精密主要於中國製造及銷售柔性印刷電路板。誠如本公司日期為二零零六年九月二十六日之招股章程所披露，瀚宇精密自二零零五年十二月十五日成立以來一直為瀚宇台灣所製造之柔性印刷電路板進行生產工序之最後階段及測試，以於中國分銷。由於本集團並無生產柔性印刷電路板所需之重要設計及工程專業知識，瀚宇精密並無列作本公司之上市集團公司之一，以便本公司專注於其PCB業務，而由於瀚宇台灣自二零零五年七月首次開始其柔性印刷電路板業務以來已開始獲取柔性印刷電路板生產過程所需之相關經驗及專業知識，故瀚宇精密於二零零六年四月以來一直由瀚宇台灣持有作為其間接全資附屬公司。經過不斷改進製造設備及設施以及生產員工之技能後，瀚宇精密現時擁有完成柔性印刷電路板主要生產程序所需之重要設計及工程專業知識。

下表為瀚宇精密截至二零零六年十二月三十一日止年度及截至二零零七年十一月三十日止十一個月之損益表之摘要。

	截至 二零零六年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元	截至 二零零七年 十一月三十日 止十一個月 (經審核) 人民幣千元
營業額	9,752	10,494
經營溢利／(虧損)	(3,808)	(6,482)
除稅及少數股東權益前溢利／(虧損)	(3,808)	(6,453)
溢利／(虧損)淨額	(3,808)	(6,453)

有關瀚宇台灣之資料

瀚宇台灣為於一九八九年三月二十二日在台灣註冊成立之有限公司，現時於台灣證交所上市。於本公佈日期，瀚宇台灣之最大股東為華新麗華，華新麗華連同其聯繫人士持有瀚宇台灣之全部已發行股本約57.94%。自其成立以來，瀚宇台灣之主要業務一直為生產及銷售印刷電路板。現時，瀚宇台灣於台灣設有兩個印刷電路板生產廠房，每月總產能為450,000平方呎印刷電路板。除其印刷電路板業務外，瀚宇台灣自二零零五年七月以來亦一直從事製造及銷售柔性印刷電路板。瀚宇台灣之柔性印刷電路板工場之建築樓面面積約為12,040平方米，計劃每月產能為120,000平方呎柔性印刷電路板。瀚宇台灣亦透過其間接全資附屬公司瀚宇精密於中國生產及銷售柔性印刷電路板。除上文所披露者外，於本公佈日期，瀚宇台灣並無從事任何其他業務。

釋義

「收購事項」	指	瀚宇香港在該協議之條款及條件之規限下收購瀚宇精密之全部股本權益
「該協議」	指	瀚宇香港與瀚宇精密薩摩亞根據收購事項於二零零七年十二月二十四日訂立之協議
「聯繫人士」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	瀚宇博德國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「代價」	指	根據該協議之條款應付予瀚宇精密薩摩亞之1,900,000美元(約14,780,000港元)
「控股股東」	指	具備上市規則所賦予之涵義

「董事」	指	本公司董事
「柔性印刷電路板」	指	柔性印刷電路板，使用柔性基料(不論有無柔性蓋層)之模式印刷電路裝置
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「瀚宇江陰」	指	瀚宇博德科技(江陰)有限公司，一家於二零零二年四月十九日在中國成立之外商獨資企業，為瀚宇香港之直接全資附屬公司
「瀚宇香港」	指	瀚宇博德(香港)控股有限公司，一家於二零零七年十一月二十六日在香港註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「瀚宇精密」	指	瀚宇精密科技(江陰)有限公司，一家於二零零五年十二月十五日在中國成立之外商獨資企業，為瀚宇台灣之間接全資附屬公司及瀚宇精密薩摩亞之直接全資附屬公司
「瀚宇精密薩摩亞」	指	HannStar Board Precision (SAMOA) Holdings Corp.，一家於二零零六年三月二十九日在薩摩亞註冊成立之有限公司，為瀚宇台灣之間接全資附屬公司
「瀚宇台灣」	指	瀚宇博德股份有限公司，一家於一九八九年三月二十二日在台灣註冊成立之有限公司，由華新麗華及其聯繫人士擁有約57.94%權益，其股份於台灣證交所上市
「高密度互連結板」	指	高密度互連結板，每個單位面積之電路密度較傳統基版或底版為高之基版或底版
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市」	指	本公司股份於二零零六年十月六日在聯交所主板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新台幣」	指	新台幣，台灣法定貨幣
「印刷電路板」	指	印刷電路板，用於嵌裝電子部件之電路板，通常由一面或兩面以化學方法蝕刻有電路之帶有銅質塗層之絕緣材料製成，此種電路板其後經鑽孔並在孔中嵌裝部件，然後焊接至剩餘銅質基片
「中國」	指	中華人民共和國
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則

「招股章程」	指	本公司於二零零六年九月二十六日就上市刊發之招股章程
「剛柔電路板」	指	剛柔電路板
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「機頂盒」	指	機頂盒，接駁電視及若干外界訊號來源，將訊號轉化成內容，然後在屏幕上播放之工具
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「台灣證交所」	指	台灣證券交易所
「華科博德」	指	華科博德股份有限公司，一家於二零零七年三月二十日在台灣註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「華新麗華」	指	華新麗華股份有限公司，一家於一九六六年十二月二日在台灣註冊成立之有限公司，其股份於台灣證交所上市，為瀚宇台灣之最大股東，連同其聯繫人士持有瀚宇台灣於本公佈日期之已發行股本約57.94%
「%」	指	百分比

為方便說明，人民幣及美元乃分別按人民幣1.00元兌1.056港元及1.00美元兌7.78港元之匯率換算為港元。

承董事會命
瀚宇博德國際控股有限公司
主席
焦佑衡

香港，二零零七年十二月二十四日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事葉新錦先生及勞立華先生，兩名非執行董事焦佑衡先生及何藹棠先生，以及五名獨立非執行董事趙元山先生、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」